



Company prospectus

O-TEC
Ohmura "The Technical Experts"

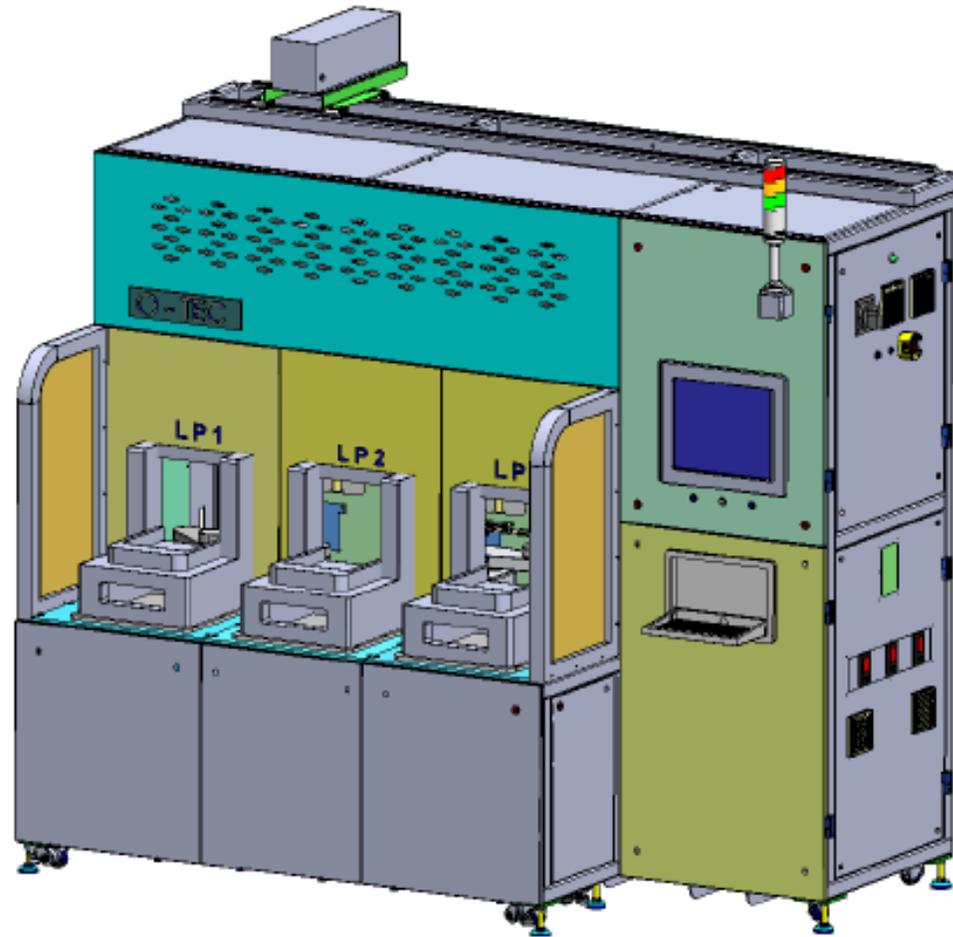
<http://www.otec-jp.com>

O-TEC 大村技研株式会社
Ohmura "The Technical Experts"

TKS 販売代理店
ティー・ケイ・エス株式会社

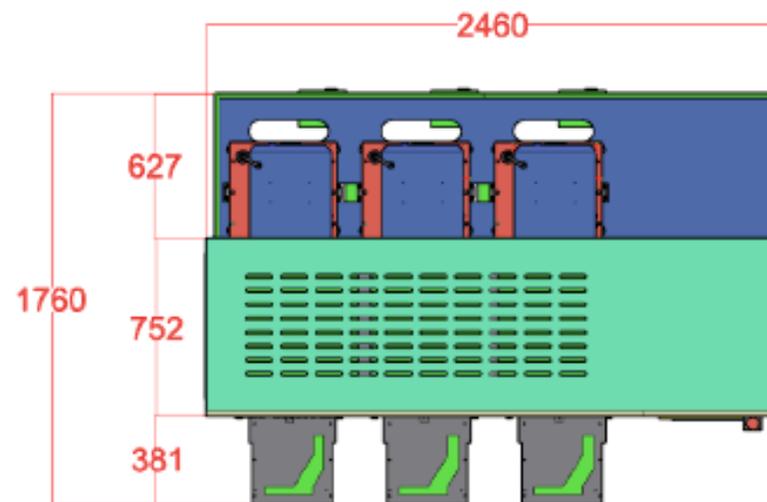
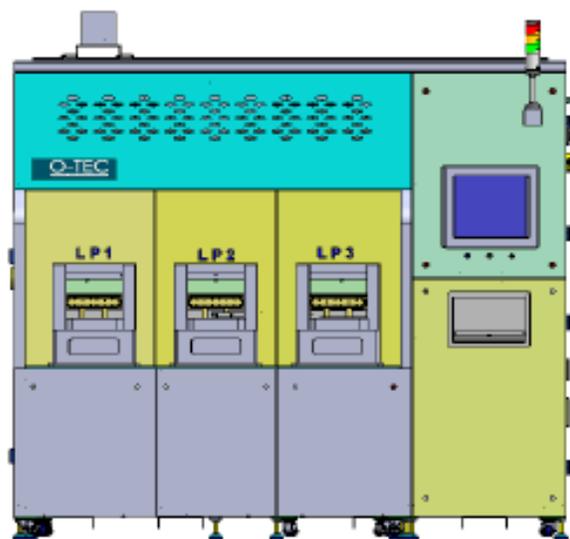
枚葉PR除去装置

装置仕様

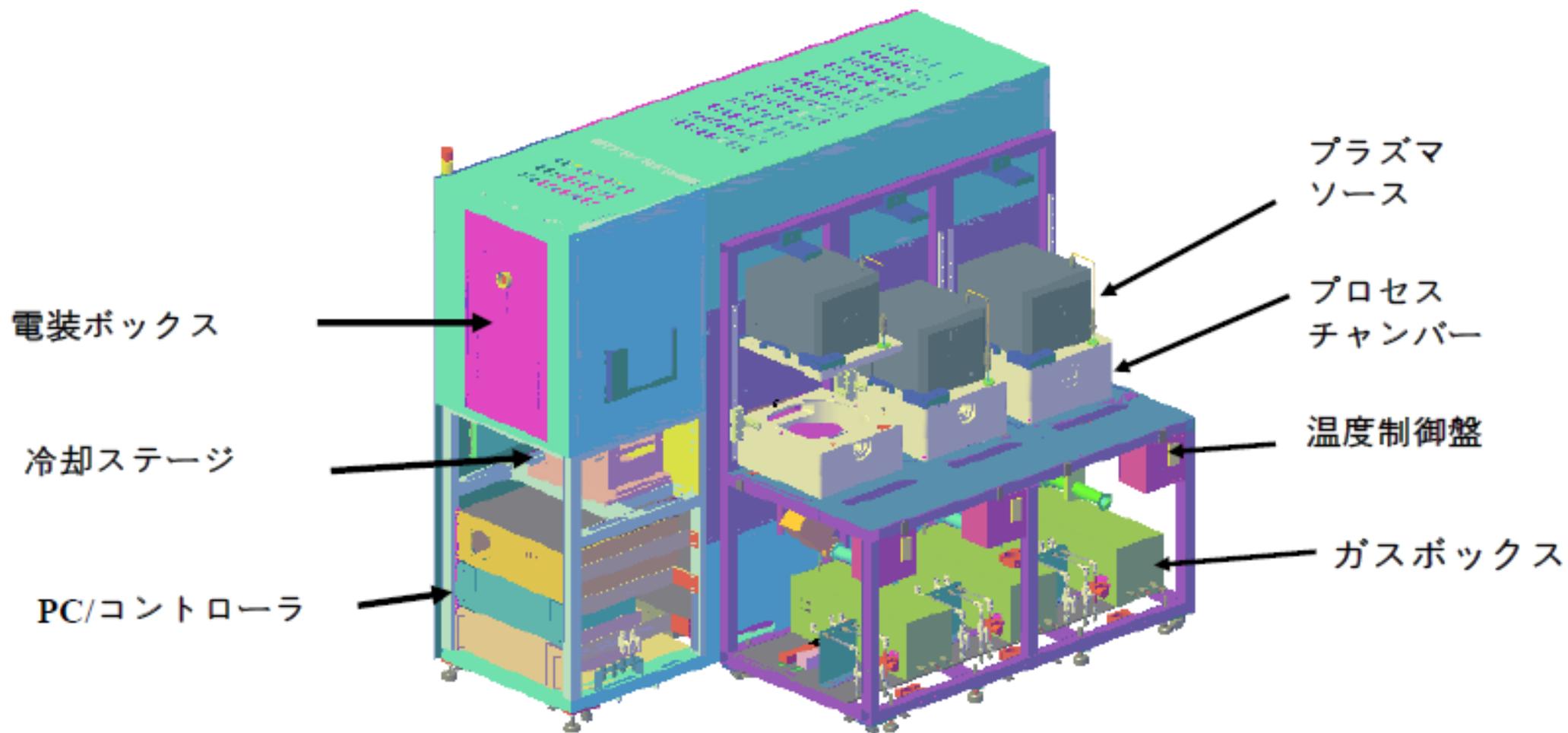


- フットプリント (3SMIFx3PM)
 - D1760 x W2460mm
- 処理能力(3PM)
 - >150枚/時間(30秒工程時間)
- コントロールユニット
 - PLCコントロール
 - デバイスネット
- EFEM
 - 3 SMIF (standard)/カセット
 - デュアルアームエンドイフェクト
 - 多層冷却ステージ
- プロセスチャンパーモジュール
 - リモートプラズマソース
 - 温度制御 (60-250°C)
 - ウェーハヒータチャック
 - イージーメンテナンス
 - 最小限のプロセスキット
- 自動化
 - SECS-GEM/HSMS / OHT対応

装置レイアウト



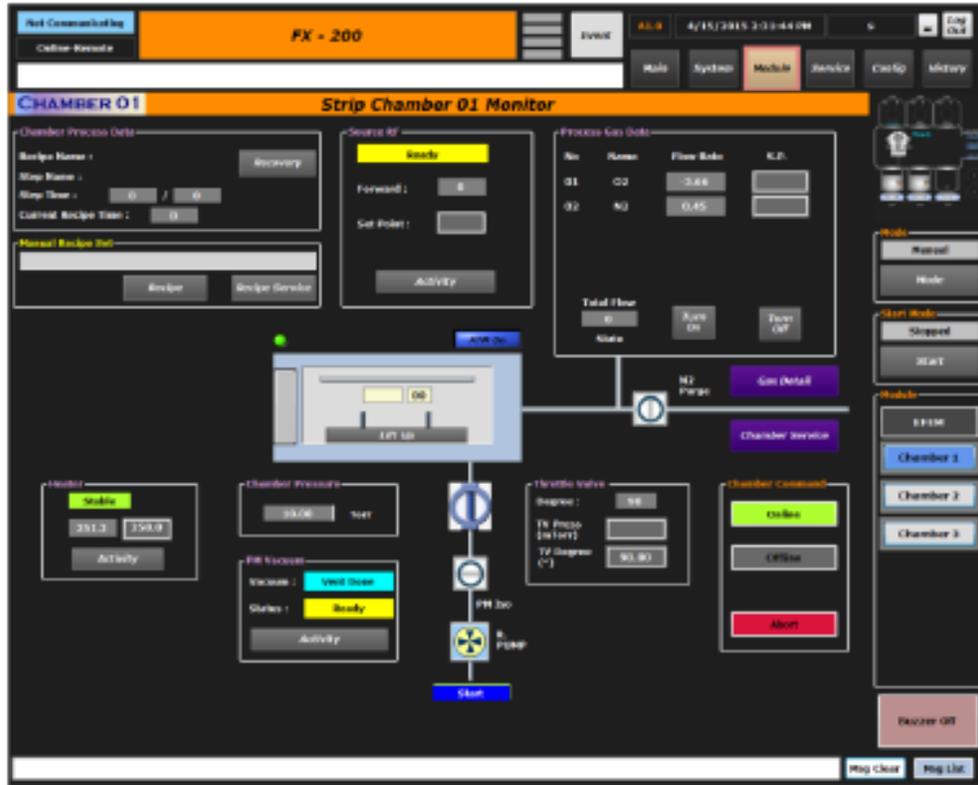
装置仕様



量産装置



装置モニター



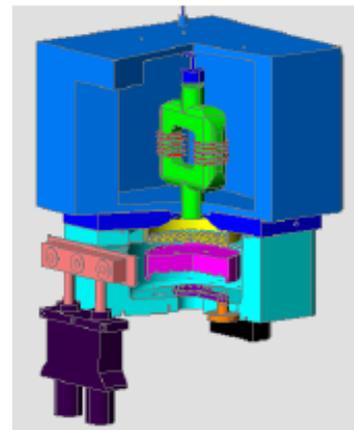
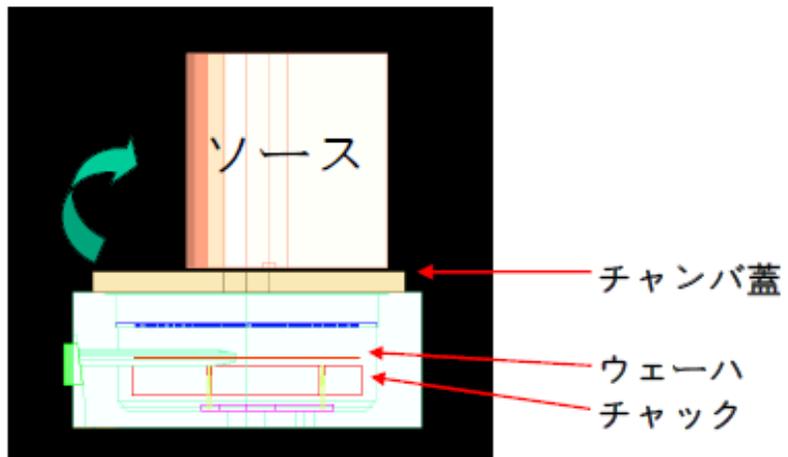
チャンバモニター画面



ウェーハモニター画面

プロセスチャンバ

プロセスチャンバ& プラズマソース

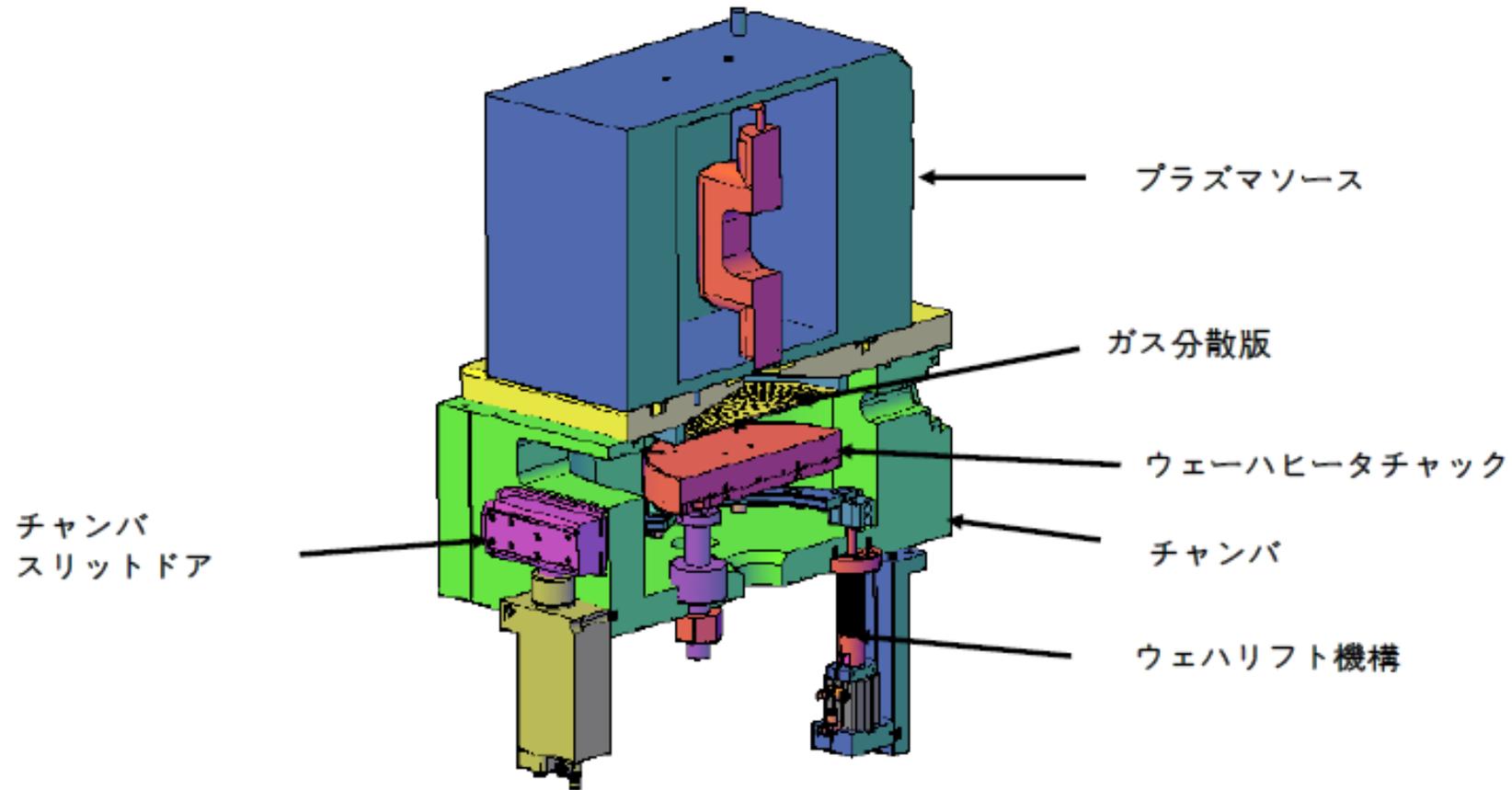


チャンバ & ソース概略図

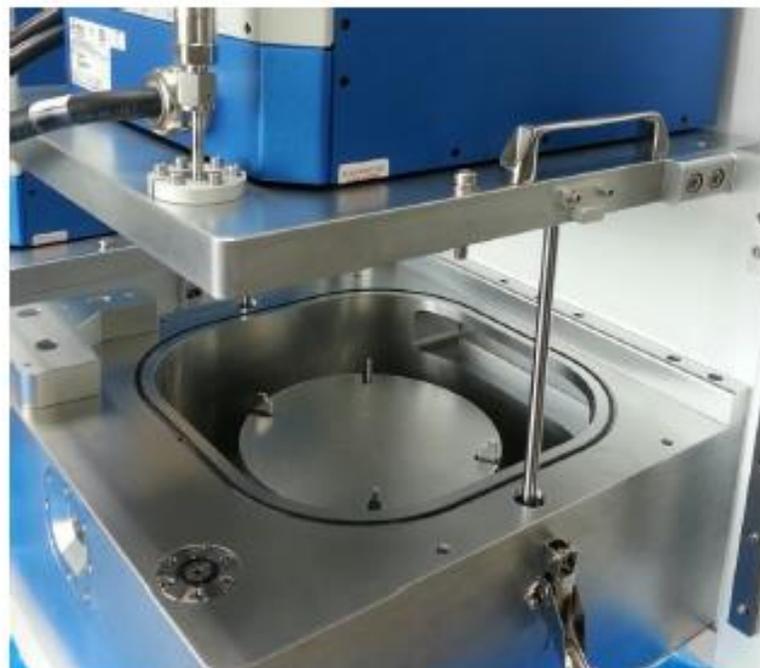
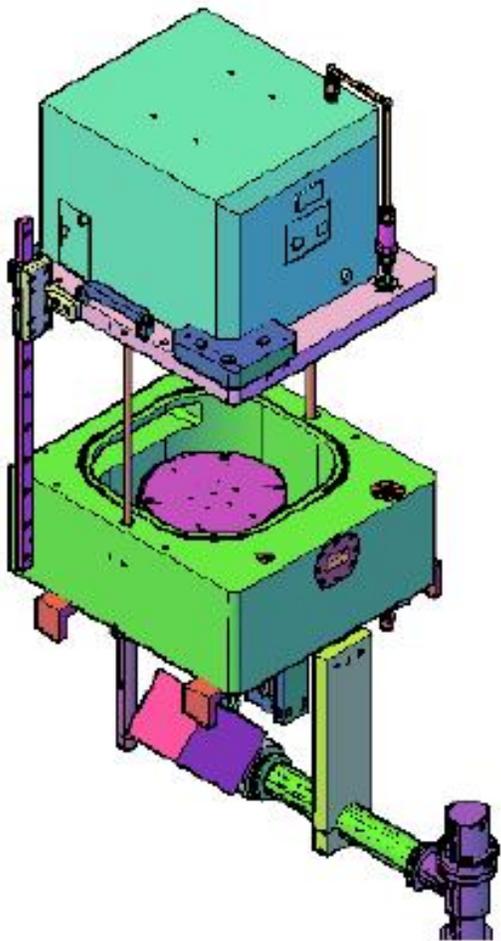
プロセスチャンバコンセプト

- 最小限のプロセスキット
- イージーメンテナンス
- 均一ガス分布
- 高密度リモートプラズマソース
- ダメージフリープラズマソース

プロセスチャンバ概略図

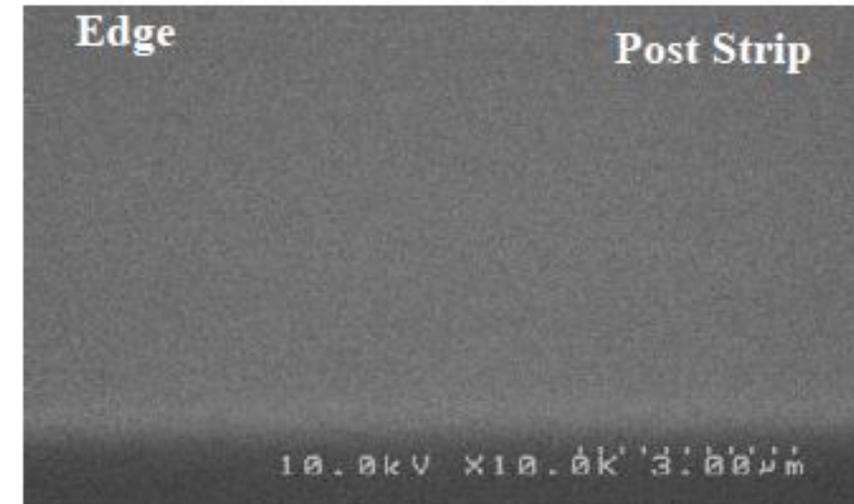
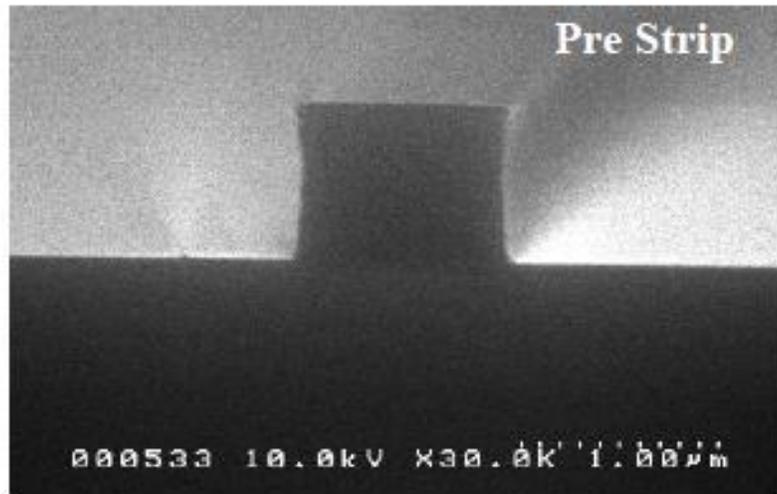
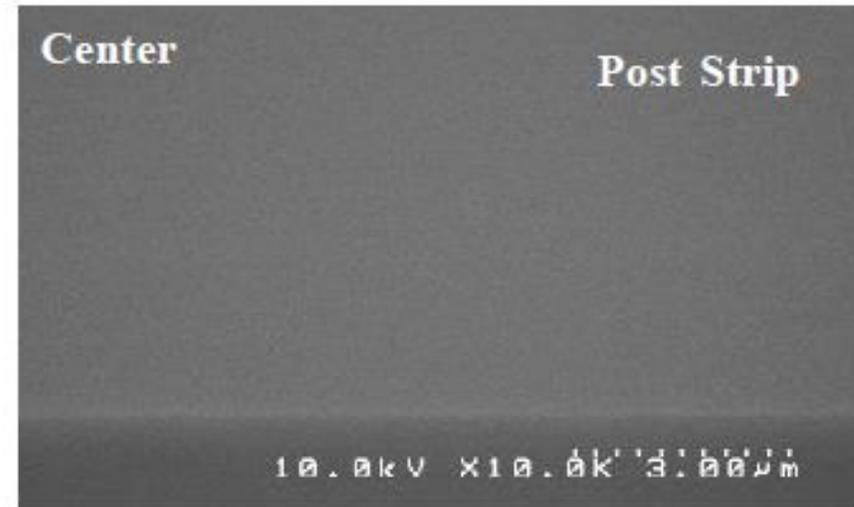
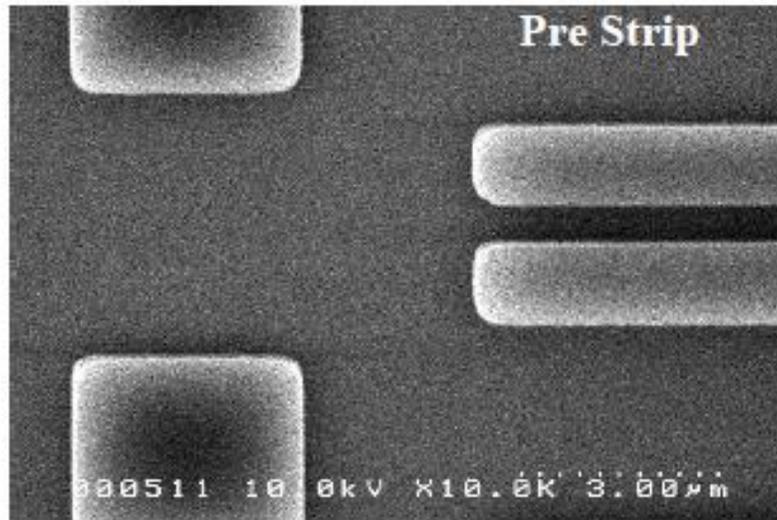


プロセスチャンバOpen状態

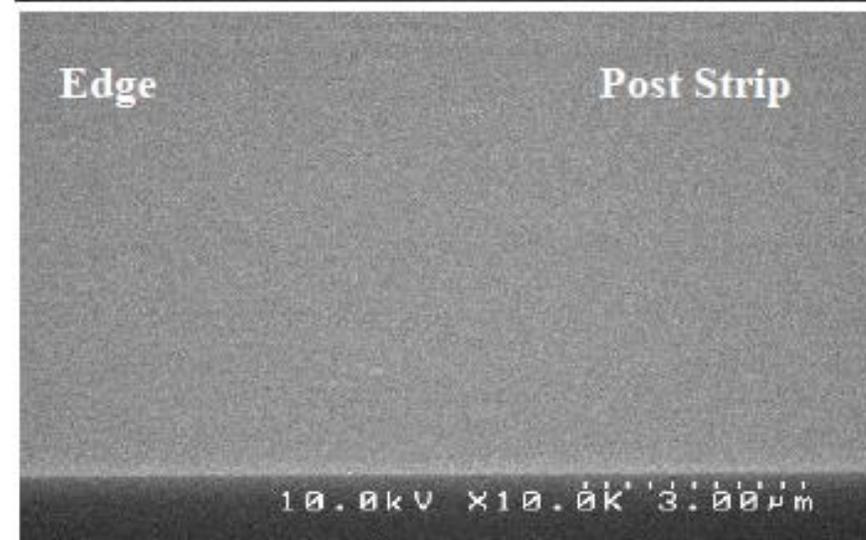
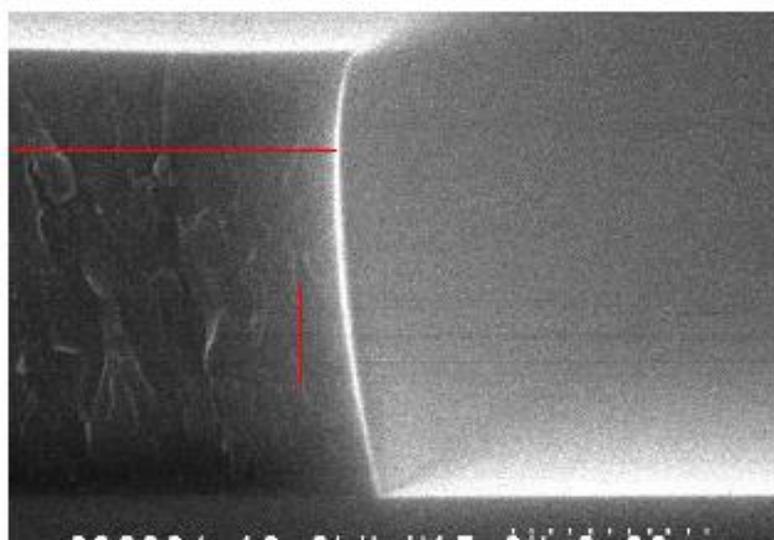
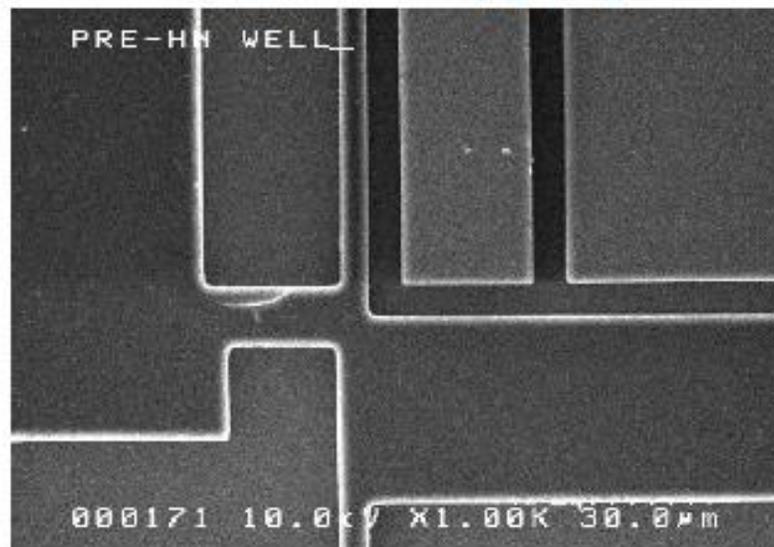


プロセスデータ

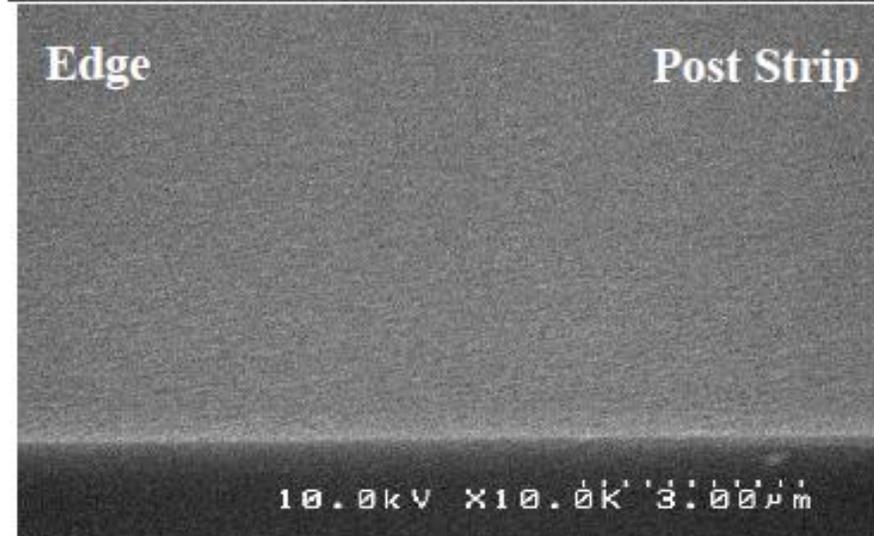
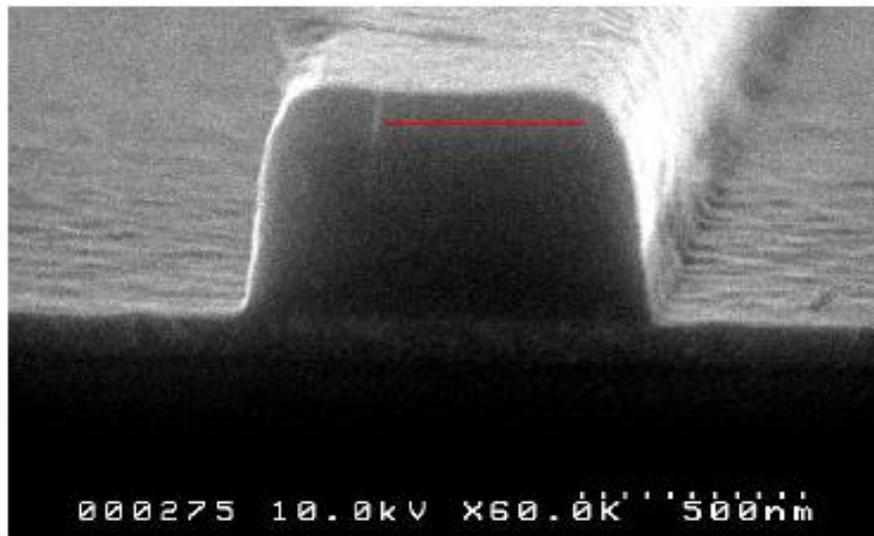
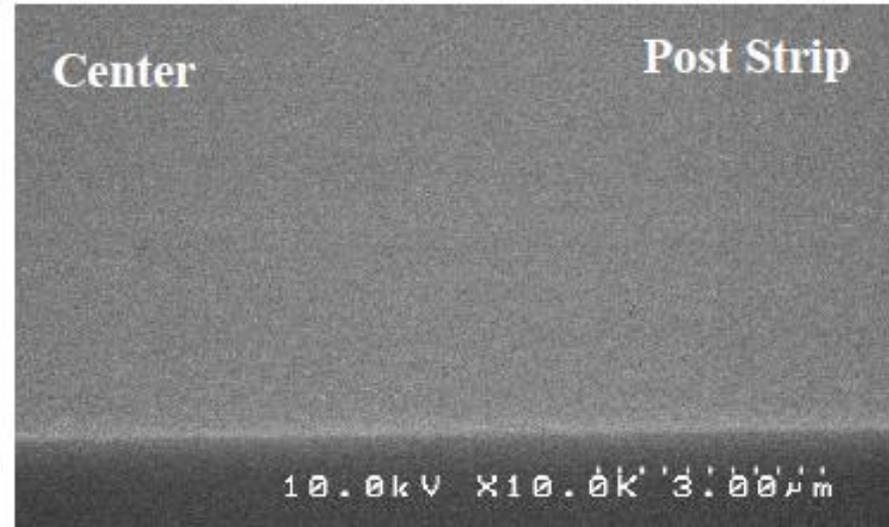
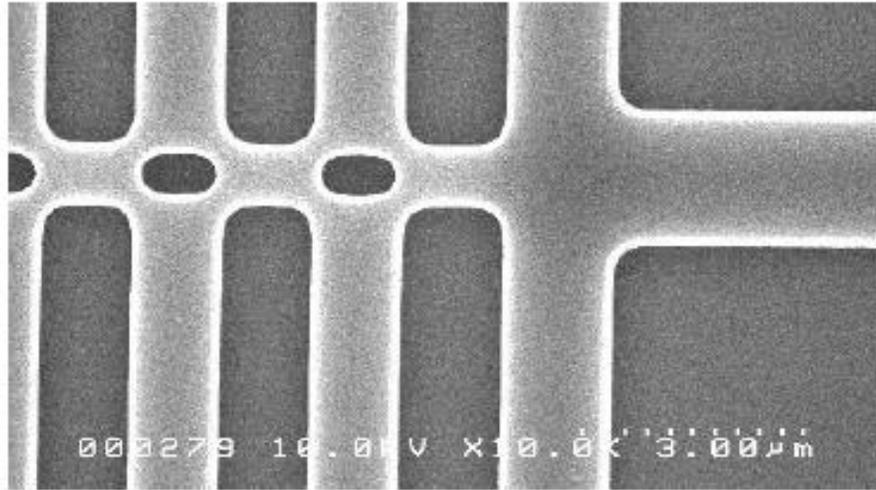
イオン注入PR除去：Block PR



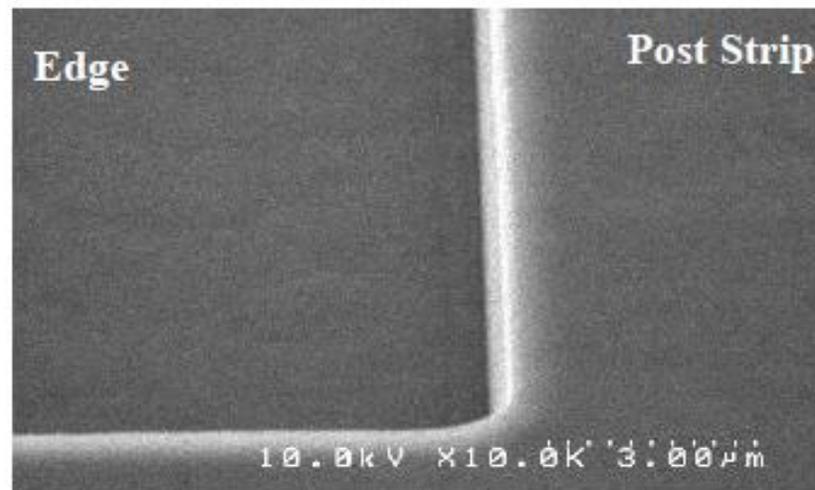
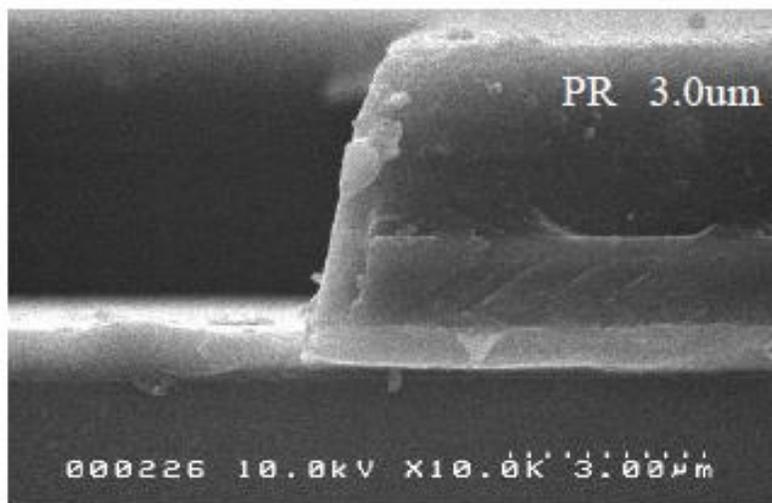
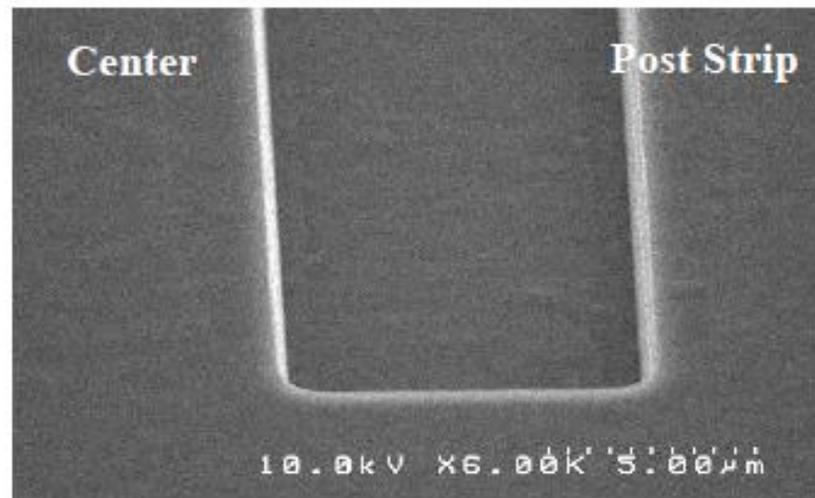
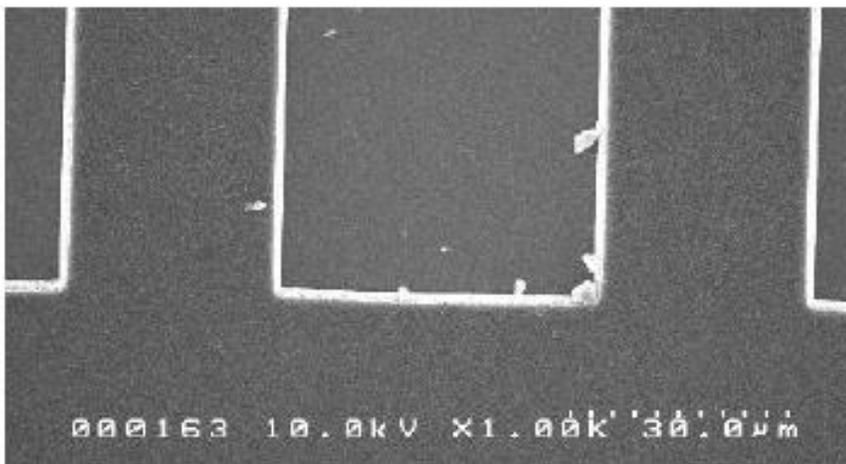
イオン注入PR除去：HN Well



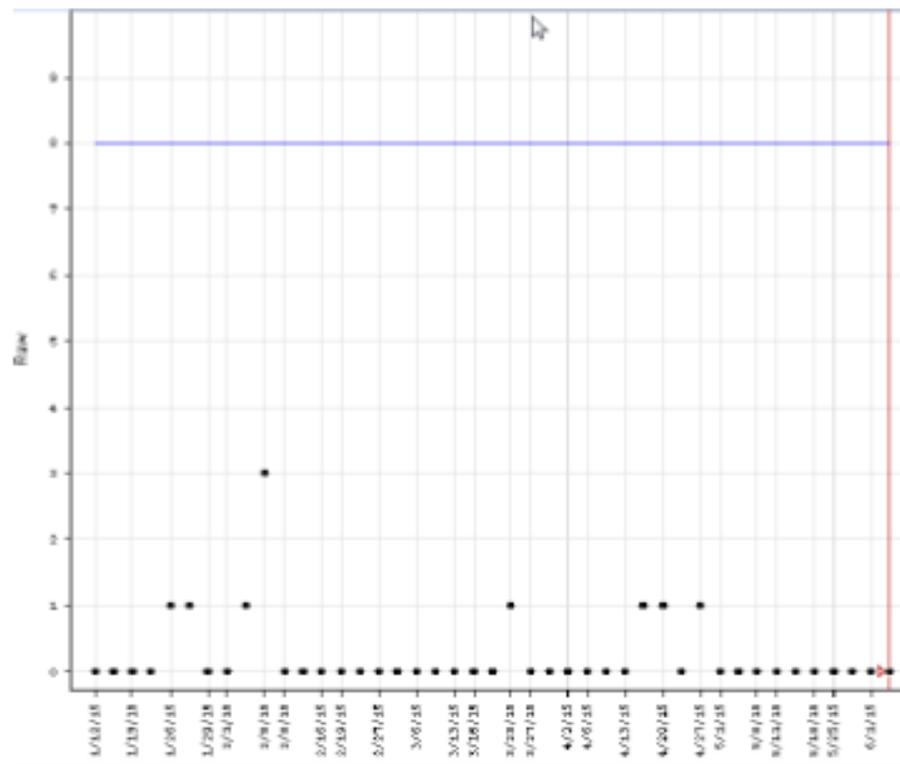
イオン注入PR除去：Poly



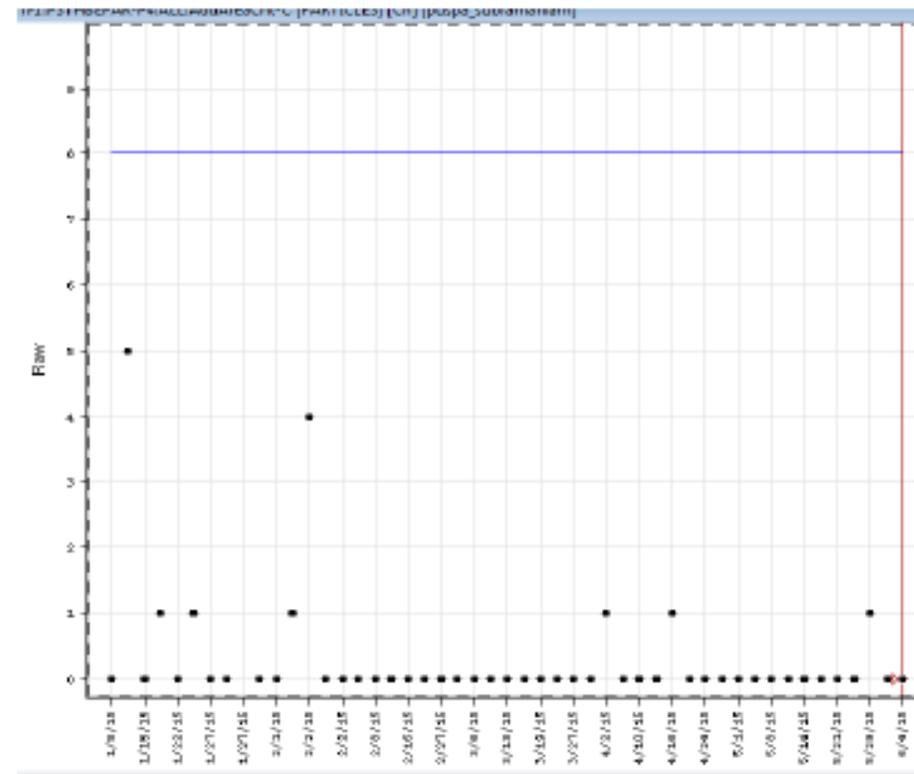
PR除去：PAD



Particle Data (6か月)



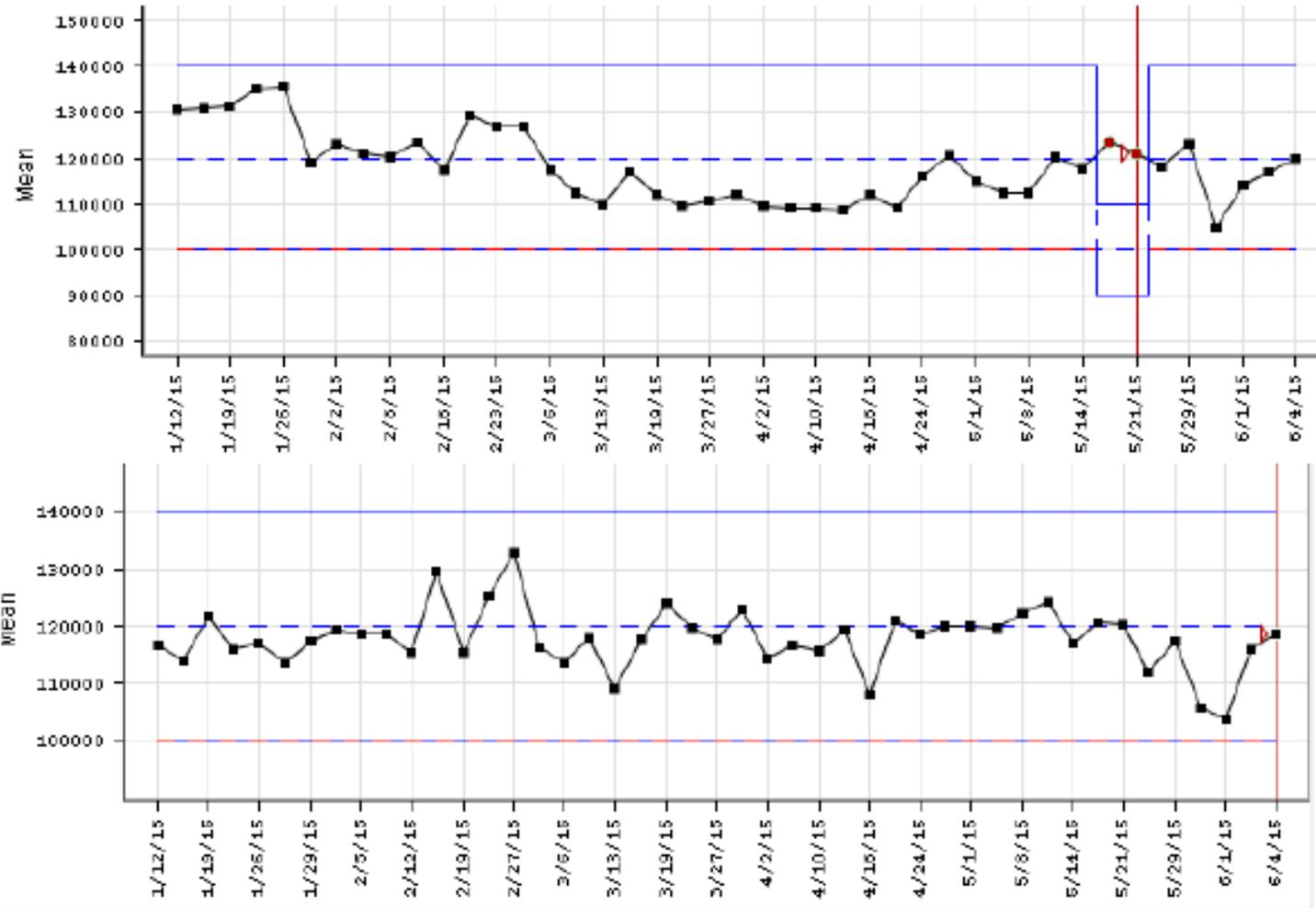
チャンバA



チャンバB

• Particle Performance: <3 adds @>0,12um

6か月PR除去データ



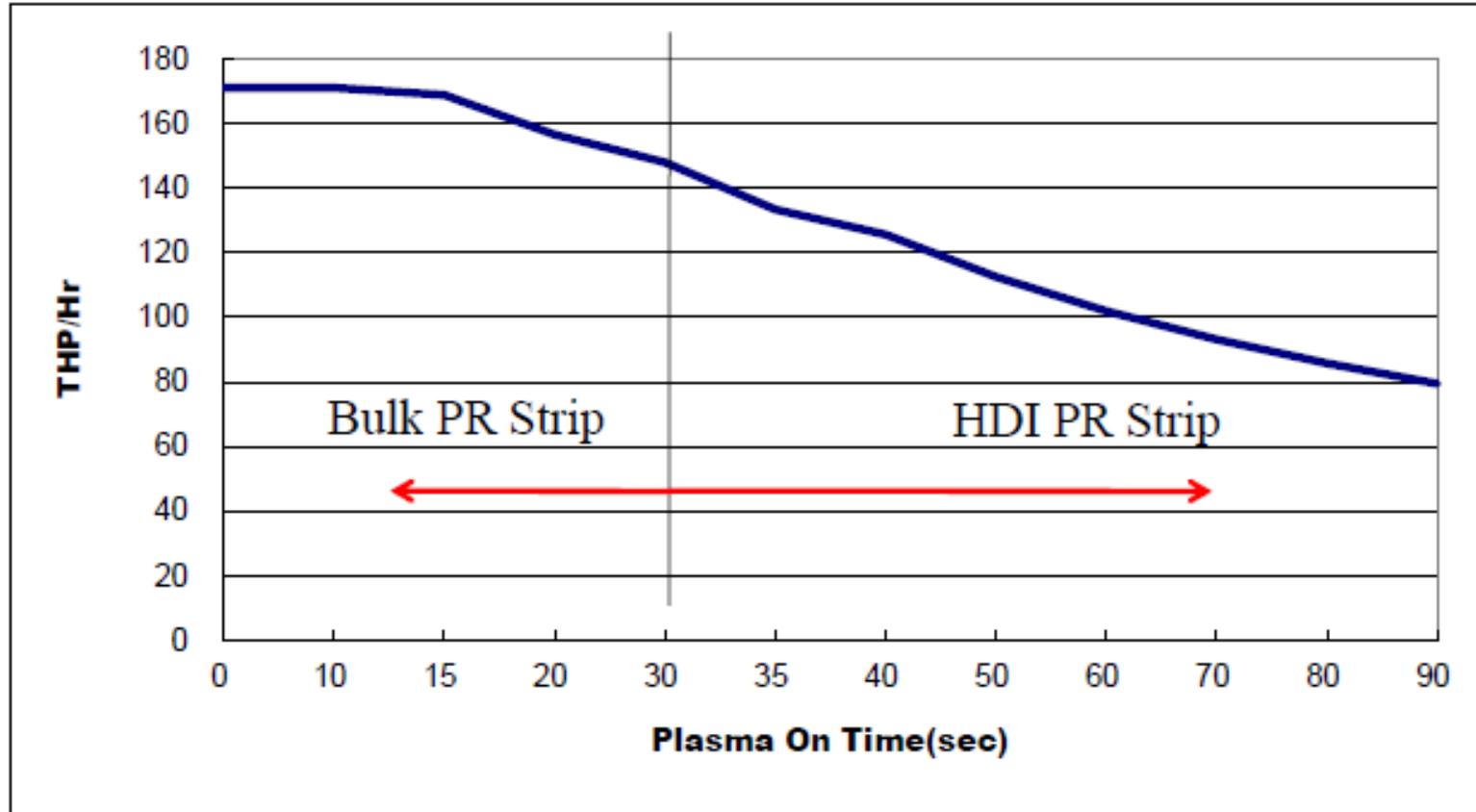
Chamber A

Chamber B

装置性能評価

| | |
|------------------|--------------------|
| 要求条件 | FX 200 Performance |
| PR除去レート (um/min) | ≥10um/min |
| 面内均一性 (+/-%) | ≤±5 |
| プラズマダメージ | None |
| MTBF | >400Hrs |
| MTBC | >100,000 |
| MTTR | <3 hrs |
| Particle性能 | < 5 ea @> 0.12um |

Through Put



(3チャンバ連続処理モード)